

# 半导体行业复苏迹象清晰，多家公司迎来业绩拐点

半导体

推荐 (维持)

## 核心观点:

- 行业新闻:** 1) SIA 和 SEAJ 发布行业数据, 2024 年 2 月全球半导体销售额和 2024 年 3 月日本半导体设备销售额均实现同比增长。Knometa Research 数据显示, 2023 年中国大陆晶圆月产能占全球比重为 19.1%, 预计 2026 年将超越韩国和中国台湾。2) 存储芯片持续火热, 三星电子将企业用 SSD 价格上调 20%-25%; SK 海力士宣布与台积电共同研发下一代 HBM, 并继续投资建设 DRAM 生产基地, 美光也计划在美投资 DRAM “超级晶圆厂”。3) 在 AI 芯片驱动的行业上行周期背景下, 日本半导体材料大厂 Resonac 力拼将产能扩大至目前的 3.5-5 倍。我国光刻胶技术也迎来新突破, 半导体材料国产化指日可待。
- 重点公司公告:** 华海诚科、天岳先进、通富微电、甬矽电子、长川科技和江丰电子等公司纷纷发布 2023 年和 2024Q1 业绩公告。2023 年, 受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突和行业周期性波动等多重负面因素影响, 半导体行业需求出现较大波动, 整体呈周期性下行态势, 部分公司业绩承压。2024 年 Q1, 半导体下游需求复苏, 市场行情回暖, 大部分公司业绩明显改善, 半导体行业周期拐点愈发清晰。
- 板块跟踪:** 1) 近一个月半导体指数表现: 从涨跌幅水平来看, 半导体行业指数跑输沪深 300 指数 6.92 个百分点, 跑输电子指数 1.62 个百分点。从具体数据来看, 半导体行业指数涨跌幅为 -5.26%, 电子行业指数涨跌幅为 -3.64%, 沪深 300 指数涨跌幅为 1.66%。2) 近一年半导体指数表现: 从涨跌幅水平来看, 面板行业指数跑赢沪深 300 指数 4.29 个百分点, 跑赢电子指数 7.55 个百分点。从具体数据来看, 半导体行业指数涨跌幅为 -5.26%, 电子行业指数涨跌幅为 -12.81%, 沪深 300 指数涨跌幅为 -9.55%。3) 2023 年&2024 年一季度业绩表现: 半导体设备板块维持高景气度, 预计今年仍将保持稳定增速; 半导体材料厂商业绩表现分化, 电子特气、湿电子化学品等逐步实现国产替代的中高端产品表现亮眼, 但是传统业务表现差强人意; 集成电路封测赛道寒冰渐融, 预计今年业绩表现仍将遵循逐季向好的行业规律。
- 投资建议:** 半导体设备、材料和集成电路封测板块经历连续调整, 目前处于安全估值水平, 同时 2024Q1 大部分公司业绩已出现明显拐点。我们认为, 半导体部分细分板块目前具备配置价值, 建议关注半导体材料公司: 华海诚科 (688535.SH)、雅克科技 (002409.SZ)、清溢光电 (688138.SH)、江丰电子 (300666.SZ); 半导体设备公司: 北方华创 (002371.SZ)、拓荆科技 (688072.SH)、中科飞测 (688361.SH); 集成电路封测公司: 通富微电 (002156.SZ)、长电科技 (600584.SH)、甬矽电子 (688362.SH)。
- 风险提示:** 半导体行业复苏不及预期的风险, 国际贸易摩擦激化的风险, 技术迭代和产品认证不及预期的风险, 产能瓶颈的风险。

## 分析师

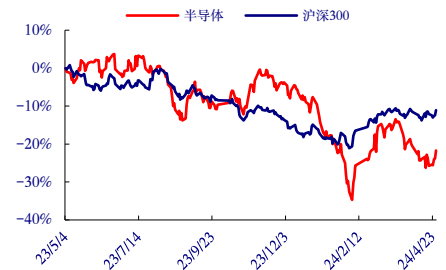
高峰

☎: 010-80927671

✉: gaofeng-yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码: S0130522040001

## 相对沪深 300 表现图



资料来源: 中国银河证券研究院

## 相关研究

【银河电子】3 月月报-存储原厂提产趋势明确, 提振设备、材料、封测需求

## 目 录

一、行业新闻：半导体复苏迹象清晰，DRAM 热度不减.....	3
二、重点公司公告：曙光初现，多家公司迎来业绩拐点.....	5
三、板块跟踪：半导体经历连续调整，处于安全估值水平.....	6
四、风险提示.....	9

## 一、行业新闻：半导体复苏迹象清晰，DRAM 热度不减

4月1日，据媒体报道，三星电子今年第二季度上调企业用 SSD 价格 20%至 25%的决策，主要源于**市场需求的剧增**。原本，三星电子计划的价格上调幅度是 15%，但显然市场需求的增长超出了预期，因此价格上调幅度有所扩大。与此同时，根据调研机构 TrendForce 的报告，消费级 SSD 的价格也预计将再次上涨，涨幅预计在 10-15%之间。这一趋势的形成，主要是由于上游减产影响的持续，以及供应商库存水平的下降。尽管第二季度的 NAND 闪存采购量略低于一季度，但闪存合约价依然有望继续上涨。（链接：<https://www.msn.cn/zh-cn/news/other/ar-BB1kSjju>）

4月1日，据日媒报道，为应对 AI 芯片的旺盛需求，日本半导体材料大厂 Resonac（旧称“昭和电工”）将扩大 AI 芯片所需的高性能半导体材料产能，力拼将产能扩大至目前的 3.5-5 倍。具体来说，增产材料主要为非导电性胶膜“NCF（Non-Conductive Film）”以及散热片“TIM（Thermal Interface Material）”，目前这两款产品已被 Resonac 客户采用，用于高性能半导体上。Resonac 指出，上述增产计划的投资额约 150 亿日元，预定将自 2024 年以后陆续启用。预计 2027 年 AI 半导体市场规模预估将扩大至 2022 年的 2.7 倍，因此 Resonac 希望将即时性扩大上述两项材料产能，以进一步巩固自身的市场优势。（链接：[https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/5772303575/1580e5cd7019014nk4?finpagefr=p\\_104](https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/5772303575/1580e5cd7019014nk4?finpagefr=p_104)）

4月2日，华中科技大学与湖北九峰山实验室组成联合研究团队，突破“**双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶**”技术。据介绍，这一具有自主知识产权的光刻胶体系已在生产线上完成了初步工艺验证，并同步完成了各项技术指标的检测优化，实现了从技术开发到成果转化全链条打通。该研究通过巧妙的化学结构设计，以两种光敏单元构建“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”，最终得到光刻图像形貌与线边缘粗糙度优良、space 图案宽度值正态分布标准差（SD）极小（约为 0.05）、性能优于大多数商用光刻胶，且光刻显影各步骤所需时间完全符合半导体量产制造中对吞吐量和生产效率的需求。（链接：<https://www.cls.cn/detail/1636213>）

4月3日，半导体行业协会(SIA)宣布，2024年2月全球半导体行业销售额总计 462 亿美元，较 2023 年 2 月的 397 亿美元增 16.3%，但较之 2024 年 1 月的 476 亿美元下降 3.1%。从地区来看，中国(28.8%)、美洲(22.0%)和亚太/所有其他地区(15.4%)的同比销售额有所增长，但欧洲(-3.4%)和日本(-8.5%)的销售额同比下降。所有市场的月度销售额均下降：亚太地区/所有其他地区(-1.3%)、欧洲(-2.3%)、日本(-2.5%)、美洲(-3.9%)和中国(-4.3%)。（链接：<https://www.199it.com/archives/1683697>）

4月10日，根据 Knometa Research 的数据显示，2026 年，中国大陆将超越韩国和中国台湾，成为 IC 晶圆产能的领先地区，而欧洲的份额将继续下降。中国一直在领先优势的芯片制造能力上进行大量投资，并将除美洲以外的所有其他地区获取市场份额。此外，Knometa Research 预计，2024 年全球 IC 晶圆产能年增长率为 4.5%，2025 年和 2026 年增长率分别为 8.2%和 8.9%。截至 2023 年底，中国大陆在全球晶圆月产能中的份额为 19.1%，落后韩国和中国台湾几个百分点。预计到 2025 年，中国的产能份额预计将达 20.1%，与领先国家或地区大致持平，2026 年则有望以 22.3%的份额占据榜首。（链接：<https://new.laoyaoba.com/n/900657>）

4月19日,韩国内存大厂SK海力士宣布,将与台积电展开深度合作,共同致力于下一代HBM(高带宽内存)产品的生产和先进封装技术的研发。双方近期已签署谅解备忘录(MOU)。在合作中,两家公司将首先针对HBM封装内最底层的基础裸片进行性能改善。SK海力士在以往的HBM产品中,包括HBM3E(第五代HBM产品),都是采用自家制程技术来制造基础裸片。然而,从HBM4产品开始,SK海力士计划采用台积电的先进逻辑制程技术。此外,SK海力士与台积电还将共同优化SK海力士的HBM产品和台积电的CoWoS技术的融合。(链接:<https://mp.weixin.qq.com/s/6g3hUuHZpAyKddjpOa7K0A>)

4月24日,台积电表示,该公司正在研发的一种名为“A16”的新型芯片制造技术将于2026年下半年投产。据介绍,A16将结合台积电的超级电轨构架与纳米片晶体管。超级电轨技术可以将供电网络移到晶圆背面,为晶圆正面腾出更多空间,从而提升逻辑密度和性能,让A16适用于具有复杂信号布线及密集供电网络的高效能运算(HPC)产品。相较于N2P制程,A16芯片密度提升高达1.10倍,在相同工作电压下,速度增快8-10%;在相同速度下,功耗降低15-20%。除了A16外,台积电还宣布将推出N4C技术,N4C延续了N4P技术,晶粒成本降低高达8.5%且采用门槛低,预计于2025年量产。(链接:<https://new.qq.com/rain/a/20240425A03KPY00>)

4月24日,韩国存储芯片制造商SK海力士表示,计划投资5.3万亿韩元(约合38.6亿美元)在韩国建设一家新的动态随机存取存储器(DRAM)芯片生产基地。新生产基地旨在增加DRAM产能,重点是HBM,预计HBM市场年增长率将超过60%。在服务器大容量芯片产品的带动下,通用DRAM的需求稳步增长。(链接:[https://www.enicn.com/Enicn/2024/article\\_0425/75363](https://www.enicn.com/Enicn/2024/article_0425/75363).)

4月25日,美国政府近日宣布,根据双方签订的不具约束力的初步备忘录,美国政府将根据《芯片与科学法案》向美光提供至多61.4亿美元(当前约445.76亿元人民币)直接补贴。这笔补贴将支持美光到2030年在美国投资500亿美元,在纽约州克莱建设两座先进DRAM内存“超级晶圆厂”;并在总部所在地爱达荷州博伊西建设一座先进DRAM内存大规模量产工厂。美光博伊西晶圆厂将于2025年上线投运,2026年启动DRAM生产;美光在克莱的首座晶圆厂2025年开始建设,2028年上线。(链接:<https://www.ithome.com/0/764/259.htm>)

4月26日,日本半导体制造装置协会(SEAJ)最新公布统计数据指出,2024年3月份日本制芯片设备销售额(3个月移动平均值、包含出口)为3,656.80亿日圆、较去年同月成长8.5%,连续第3个月呈现增长、创11个月来(2023年4月以来、成长9.8%)最大增幅,月销售额连续第5个月突破3,000亿日圆大关、创下单月历史次高纪录(仅低于2022年9月的3,809.29亿日圆)。和前一个月份(2024年2月)相比、大增15.2%,连续第5个月呈现月增。(链接:<https://mp.weixin.qq.com/s/Y3m7D2Liw2IPIEGgCTxpow>)

4月26日,全球知名外包半导体组装和测试承包商京元电子(KYEC)宣布,将出售其位于中国苏州的子公司金龙科技的股份,并全面退出中国大陆市场。此次京元电子投资策略的重大转变,主要是因为受到中美芯片战争影响。出售金龙科技股份旨在降低因中美紧张关系带来的风险敞口,将业务重心转移至更加稳定和支持性的商业环境,并将资金回流,计划投资于高端应用芯片所需的测试和组装设备,这些领域目前在市场上几乎空白。(链接:<http://www.cepem.com.cn/news/detail/4553>)

## 二、重点公司公告：曙光初现，多家公司迎来业绩拐点

**华海诚科：**4月2日，发布《2023年年度报告》。2023年公司实现营业收入28,290.22万元，同比-6.7%，其中上半年实现营业收入12,624.29万元，下半年实现营业收入15,665.93万元。公司产能利用率逐季回升。2023年归属于母公司所有者的净利润约3163.86万元，较上年同期-23.26%。4月29日，发布《2024年第一季度报告》。公司2024年第一季度营业收入约7240.26万元，较上年同期同比增长约33.19%。2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润约1277.17万元，较上年同期增长207.3%。

**天岳先进：**4月12日，发布《2023年年度报告》。2023年，公司实现营业总收入125,069.57万元，较上年同期增加199.90%；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入125,045.55万元，较上年同期增加199.92%；基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增加；实现归属于母公司所有者的净利润-4,572.05万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,272.08万元，较上年同期亏损收窄。4月29日，发布《2024年第一季度报告》。2024年第一季度，公司实现营业总收入426,06.85万元，较上年同期增加120.66%；实现归属于母公司所有者的净利润4609.99万元。

**通富微电：**4月13日，发布《2023年年度报告》。2023年，公司实现营业收入222.69亿元，同比增长3.92%。根据芯思想研究院发布的2023年全球委外封测榜单，在全球前十大封测企业2023年营收普遍下降的情况下，公司营收略有增长。2023年，公司实现归属于母公司股东的净利润1.69亿元，同比下降66.24%。由于报告期内，半导体市场经历了起伏，公司传统业务遭遇较大挑战，导致公司产能利用率及毛利率下降。4月27日，发布《2024年第一季度报告》。2024年第一季度，公司的营业收入为52.82亿元，同比增长13.79%；归属于上市公司股东的净利润0.98亿元，同比增长2064.01%。

**甬矽电子：**4月18日，发布《2023年年度报告》。报告期内，公司实现营业收入239,084.11万元，较上年同期增长9.82%；但由于下游客户整体订单仍较为疲软，部分产品线订单价格承压，导致公司毛利率较去年同期仍有所下降；同时，公司二期项目建设有序推进，公司人员规模持续扩大，人员支出及二期筹建费用增加，使得管理费用同比增长71.97%；综合导致公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下滑167.48%。4月18日，发布《2024年第一季度报告》。2024年第一季度，得益于部分客户所处领域的景气度回升、新客户拓展及部分原有客户的份额提升，公司实现营业收入7.27亿元，同比增长71.11%，营收规模大幅提升。毛利率方面，由于营收规模的扩大，规模效应逐渐体现，2024年第一季度整体毛利率为14.23%，同比提升5.84个百分点；净利润亏损幅度明显收窄，归属于上市公司股东的净利润较去年同期同比改善28.91%。

**长川科技：**4月24日，发布《2023年年度报告》。公司2023年营业收入约17.75亿元，同比减少约31.11%。2023年归属于母公司所有者的净利润约0.45亿元，较上年同期-90.21%。4月24日，发布《2024年第一季度报告》。公司2024年第一季度营业收入约5.59亿元，同比增长约74.81%。2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润约407.5万元，较上年同期增长107.12%。

**江丰电子：**4月25日，发布《2023年年度报告》。公司2023年营业收入约26.02亿元，较2022年增加约2.77亿元，同比增长约11.89%。2023年归属于母公司所有者的净利润约2.56亿元，较上年同请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。



期-3.35%。4月25日，发布《2024年第一季度报告》。公司2024年第一季度营业收入约7.72亿元，较2023年第一季度增加约2.07亿元，同比增长约36.65%。2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润约0.60亿元，较上年同期增长7.16%。

**华锋测控：**4月26日，发布《2023年年度报告》。2023年上半年，在国内经济缓慢复苏、国外经济增速放缓以及局部地缘冲突等多种因素叠加的影响下，整个半导体市场需求疲软，半导体行业景气度持续下行，半导体设备领域的增速持续放缓。报告期内，公司的营业收入为690,861,889.19元，同比降低35.47%；归属于上市公司股东的净利润251,652,296.29元，同比降低52.18%。到了下半年，随着AI等创新技术的发展，带动了工业、通讯和消费电子市场的复苏，公司的订单逐步出现回暖。

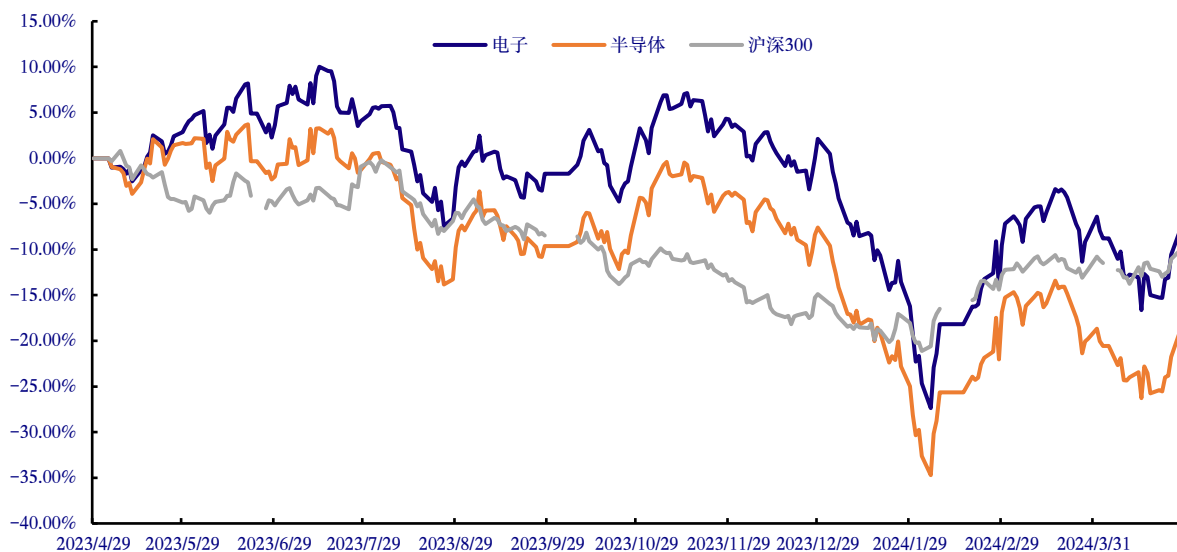
**芯源微：**4月27日，发布《2023年年度报告》。2023年，公司营业收入同比增长23.98%，主要原因是随着公司持续的研发投入，产品性能及服务水平不断提升，产品布局逐渐完善，产品综合竞争力持续增强，客户对公司产品的认可度不断提高，收入规模持续增长；归属于上市公司股东的净利润同比增长25.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长36.37%，主要原因是报告期内公司销售收入增长。4月27日，发布《2024年第一季度报告》。2024年第一季度，受存量订单结构、生产交付及验收周期等因素影响，公司营业收入同比减少15.27%，归母净利润同比减少75.73%。

### 三、板块跟踪：半导体经历连续调整，处于安全估值水平

**近一个月半导体指数表现：**从涨跌幅水平来看，半导体行业指数跑输沪深300指数6.92个百分点，跑输电子指数1.62个百分点。从具体数据来看，半导体行业指数涨跌幅为-5.26%，电子行业指数涨跌幅为-3.64%，沪深300指数涨跌幅为1.66%。

**近一年半导体指数表现：**从涨跌幅水平来看，面板行业指数跑赢沪深300指数4.29个百分点，跑赢电子指数7.55个百分点。从具体数据来看，半导体行业指数涨跌幅为-5.26%，电子行业指数涨跌幅为-12.81%，沪深300指数涨跌幅为-9.55%。

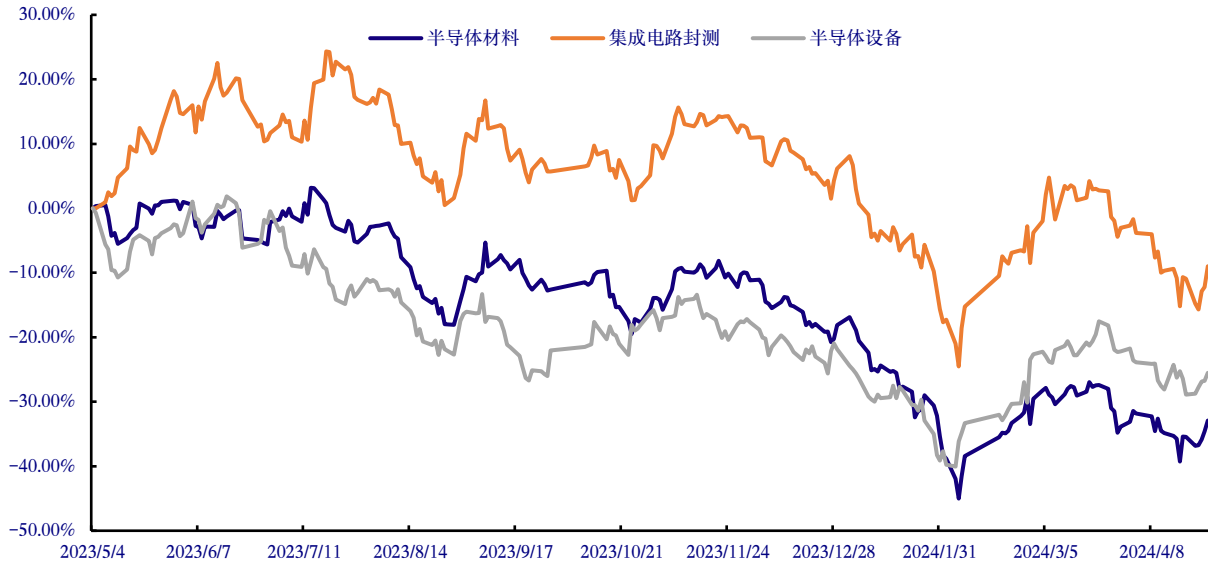
图1：2023.4.29-2024.4.29 半导体行情跟踪



资料来源：iFind，中国银河证券研究院

从细分板块指数来看，半导体设备近一个月涨跌幅为-8.95%，近一年涨跌幅为-27.98%；半导体材料近一个月涨跌幅为-2.84%，近一年涨跌幅为-35.02%；集成电路封测近一个月涨跌幅为-7.79%，近一年涨跌幅为-17%。

图2：2023.4.29-2024.4.29 半导体材料、设备、集成电路封测行情跟踪



资料来源：iFind，中国银河证券研究院

从细分板块业绩表现来看：

**半导体设备：**2023年半导体设备板块总营收507.2亿元，同比增长14.91%；归母净利润97.45亿元，同比增长8.69%；毛利率环比下降0.99PCT，净利率环比增长2.59PCT。2024Q1半导体设备板块总营收130.03亿元，同比增长28.06%；归母净利润19.91亿元，同比减少8.20%；毛利率环比下降0.64PCT，净利率环比减少3.20PCT。受益于国内晶圆厂建厂潮兴起，国产替代的持续推进，国内半导体设备板块维持高景气度。随着半导体设备公司规模的持续扩大，接受订单时间趋于均匀，叠加晶圆厂持续扩产和国产化进程持续推进双轮驱动，预计今年半导体设备板块业绩仍将保持稳定增速。

**半导体材料：**2023年半导体材料板块总营收336.15亿元，同比下降10.35%；归母净利润21.73亿元，同比下降33.06%；毛利率环比增长2.45PCT，净利率环比下降0.7PCT。2024Q1半导体材料板块总营收89.65亿元，同比增长5.37%；归母净利润3.8亿元，同比减少41.15%；毛利率环比增长0.74PCT，净利率环比增长0.26PCT。不同于半导体设备的全面向好，半导体材料厂商业绩表现分化。电子特气、湿电子化学品等逐步实现国产替代的中高端产品表现亮眼，但是传统业务表现差强人意，影响板块业绩表现。随着半导体市场行情回暖和半导体材料国产化需求提升，中高端产品占比较大的半导体材料公司有望在分化的业绩表现中脱颖而出。

**集成电路封测：**2023年集成电路封测板块总营收724.02亿元，同比下降4.34%；归母净利润26.46亿元，同比下降53.34%；毛利率环比下降3PCT，净利率环比下降3.64PCT。2024Q1集成电路封测板块总营收175.92亿元，同比增长20.69%；归母净利润3.93亿元，同比增长189.25%；毛利率环比减少1.05PCT，净利率环比减少3.15PCT。2023年，受半导体行业周期下行影响，封测厂商稼动率较低，同时行业竞争加剧，产品封装价格下降，导致板块业绩承压。2024Q1，消费市场需求趋于稳定，存储器市场回暖，AI等热点应用逐步落地，封测赛道寒冰渐融，预计今年业绩表现仍将遵循逐季向好的行业规律。

**表1: 2023 半导体材料、设备、封测行业财务表现**

	营业收入 (单位: 亿元)	营收同比 增速(单 位: %)	归母净利润 (单位: 亿 元)	总归母净利润 同比增速(单 位: %)	毛利率 (单 位: %)	毛利率环 比增 减(单 位: PCT)	净利率 (单 位: %)	净利率环 比增 减(单 位: PCT)
SW 电子	27,666.28	-2.43	1118.61	-28.44	15.83	1.42	4.02	0.29
SW 半导体	4,851.96	-0.60	315.37	-52.96	25.62	-1.04	6.38	-2.58
SW 半导体设备	507.20	14.91	97.45	8.69	43.37	-0.99	19.41	2.59
SW 半导体材料	336.15	-10.35	21.73	-33.06	18.76	2.45	6.19	-0.70
SW 集成电路封测	724.02	-4.34	26.46	-53.34	13.51	-3.00	3.75	-3.64

资料来源: iFind, 中国银河证券研究院

**表2: 2024Q1 半导体材料、设备、封测行业财务表现**

	营业收入 (单位: 亿元)	营收同比 增速(单 位: %)	归母净利润 (单位: 亿 元)	总归母净利润 同比增速(单 位: %)	毛利率 (单 位: %)	毛利率环 比增 减(单 位: PCT)	净利率 (单 位: %)	净利率环 比增 减(单 位: PCT)
SW 电子	6644.58	14.33	272.40	60.86	15.54	-0.48	4.01	0.42
SW 半导体	1092.85	21.59	61.10	51.43	25.24	0.52	5.11	-0.37
SW 半导体设备	130.03	28.06	19.91	-8.20	43.35	-0.64	15.03	-3.20
SW 半导体材料	89.65	5.37	3.80	-41.15	17.54	0.74	3.34	0.26
SW 集成电路封测	175.92	20.69	3.93	189.25	12.73	-1.05	2.27	-3.15

资料来源: iFind, 中国银河证券研究院

从个股表现来看, 近一个月表现前十名的公司分别为清溢光电、雅克科技、和林微纳、天岳先进、中船特气、江丰电子、富创精密、顾中科技、耐科装备和路维光电。

**表3: 2024.3.29-2024.4.29 半导体材料、设备、封测行业涨幅前 10 的公司**

股票代码	股票名称	近一个月涨跌幅(单位: %)	近一年涨跌幅(单位: %)	PE-TTM
688138.SH	清溢光电	21.92	-8.49	33.83
002409.SZ	雅克科技	20.34	-5.04	46.87
688661.SH	和林微纳	17.80	-45.04	-207.93
688234.SH	天岳先进	17.75	-30.84	833.96
688146.SH	中船特气	15.47	-43.80	46.50
300666.SZ	江丰电子	9.42	-33.63	49.92
688409.SH	富创精密	8.80	-33.10	89.63
688352.SH	顾中科技	8.31	-17.45	31.91
688419.SH	耐科装备	7.13	-36.00	39.49
688401.SH	路维光电	5.92	-41.92	32.14

资料来源: iFind, 中国银河证券研究院



**表4：2024.3.29-2024.4.29 半导体材料、设备、封测行业跌幅前 10 的公司**

股票代码	股票名称	近一个月涨跌幅（单位：%）	近一年涨跌幅（单位：%）	PE-TTM
301369.SZ	联动科技	-17.38	-41.06	148.53
603061.SH	金海通	-15.03	-53.64	55.80
688037.SH	芯源微	-12.48	-66.11	66.52
301348.SZ	蓝箭电子	-11.81	63.94	172.83
301297.SZ	富乐德	-10.56	-4.75	74.99
600584.SH	长电科技	-9.75	-4.90	31.33
688720.SH	艾森股份	-8.01	21.76	82.12
603690.SH	至纯科技	-7.63	-38.69	31.44
003043.SZ	华亚智能	-7.59	-39.78	29.03
688361.SH	中科飞测	-6.79	132.12	122.40

资料来源：iFind，中国银河证券研究院

半导体设备、材料和集成电路封测板块经历连续调整，目前处于安全估值水平，同时 2024Q1 大部分公司业绩已出现明显拐点。我们认为，半导体部分细分板块目前具备配置价值，建议关注半导体材料公司：华海诚科（688535.SH）、雅克科技（002409.SZ）、清溢光电（688138.SH）、江丰电子（300666.SZ）；半导体设备公司：北方华创（002371.SZ）、拓荆科技（688072.SH）、中科飞测（688361.SH）；集成电路封测公司：通富微电（002156.SZ）、长电科技（600584.SH）、甬矽电子（688362.SH）。

## 四、风险提示

**半导体行业复苏不及预期的风险：**半导体设备、材料、封测直接受半导体景气周期影响。若半导体行业持续低迷，会对设备、材料、封测厂商产生负面影响。

**国际贸易摩擦激化的风险：**美国通过多项管制政策限制中国半导体行业发展。如果贸易战升级，将导致关税继续增加，产业链风险加剧。

**技术迭代和产品认证不及预期的风险：**半导体行业具有开拓客户时间长、客户粘性强的特点。如果技术迭代速度和产品认证速度不及预期，将失去先发优势和客户优势。

**产能瓶颈的风险：**半导体设备、材料、封测新产能的释放需要时间。如果新产能无法顺利释放，将直接影响公司业绩表现。

## 图表目录

图 1: 2023.4.29-2024.4.29 半导体行情跟踪.....	6
图 2: 2023.4.29-2024.4.29 半导体材料、设备、集成电路封测行情跟踪.....	7

## 表格目录

表 1: 2023 半导体材料、设备、封测行业财务表现.....	8
表 2: 2024Q1 半导体材料、设备、封测行业财务表现.....	8
表 3: 2024.3.29-2024.4.29 半导体材料、设备、封测行业涨幅前 10 的公司.....	8
表 4: 2024.3.29-2024.4.29 半导体材料、设备、封测行业跌幅前 10 的公司.....	9

## 分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

**高峰**，电子行业首席分析师。北京邮电大学电子与通信工程硕士，吉林大学工学学士。2年电子实业工作经验，7年证券从业经验，曾就职于渤海证券、国信证券、北京信托证券部。2022年加入中国银河证券研究院，主要从事硬科技方向研究。

## 免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

## 评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证 50 指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准。	行业评级	推荐：相对基准指数涨幅 10% 以上
		中性：相对基准指数涨幅在 -5% ~ 10% 之间
		回避：相对基准指数跌幅 5% 以上
公司评级	推荐：相对基准指数涨幅 20% 以上	
	谨慎推荐：相对基准指数涨幅在 5% ~ 20% 之间	
	中性：相对基准指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间	
	回避：相对基准指数跌幅 5% 以上	

## 联系

### 中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

### 机构请致电：

深广地区：程曦 0755-83471683 chengxi\_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun\_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru\_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang\_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

唐嫚羚 010-80927722 tangmanling\_bj@chinastock.com.cn